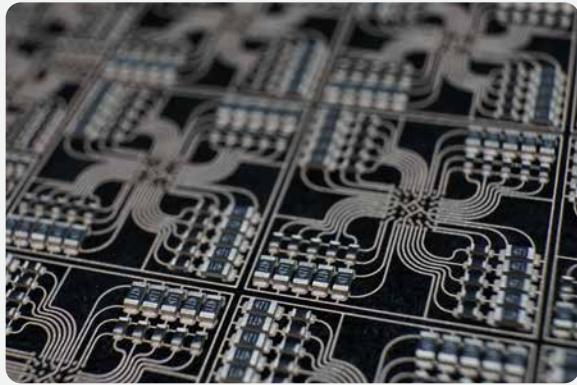


低溫固化型接著用銅膏

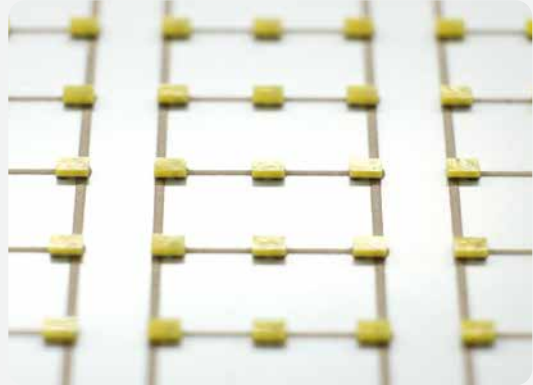
在錫膏不能對應的低溫基材上的最佳方案

用途

零件接著



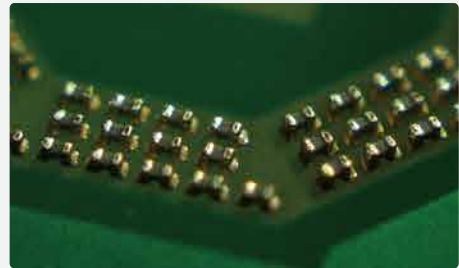
圖：可在 Glass wafer 上進行接著



圖：Polyimide 基板上接著 LED

特性

- 可低溫接著
- 擁有良好的接著性
- 對多種基材都有良好的接著性，應用性廣



可接著0201電容器

產品型錄和特性表

產品型號			AE8010
黏度	BH型	dPa·s	1,000 ~ 1,500
固化條件			120°C × 30分
體積阻抗率		Ω·cm	1.5E-04
熱傳導率		W/mK	10

